

# 關於群創 Innolux



## 產品&技術

各式尺寸顯示器  
&其他非顯示器



## 員工人數

37,000



## 公司所在地

竹南、台南、路竹



## 生產基地

台灣&大陸



## 營業據點

全球分佈  
16處據點

# 群創全球據點



# 本業深耕 跨業轉型

We are more than panel

## 顯示器領域群

(零件業務)



### 行動智慧方案事業群

手機、NB、IV、電子紙等  
中小尺寸行動智慧產品

### 大尺寸智能方案事業群

TV、MNT、醫療、航太等  
大尺寸智能產品



## 非顯示器領域群

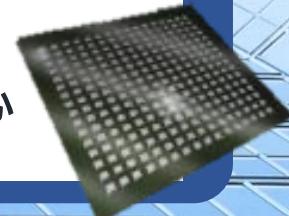
(解決方案)

### 睿生光電



### CarUX

### 先進封裝事業中心



# Display 顯示器

## LCD / microLED

miniLED背光  
(miniLED BLU)

自由行狀與曲面  
(Free-form & Curve)

極光純黑  
(PolarBlack)

高解析度VR  
(High ppi VR)

# Non-Display 非顯示器

X光感測器  
(X-ray Sensor)

指紋辨識感測器  
(Finger-Print Sensor)

PLP  
(Panel Level Package)

液晶平板天線FPA  
(Flat Panel Antenna)





## 雙翼展翅 超越面板

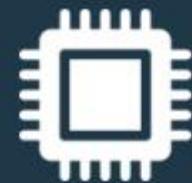
群創力拼轉型升級再登高峰，以「本業深耕、跨業轉型」雙維度展開組織再造計畫，在「顯示器領域群」中專注於面板本業的深耕，垂直整合各項嶄新技術，在良率、效能、產能提升上繼續前進；而「非顯示器領域群」包含如醫療、車用，這次群創更跨足半導體先進封裝，整合策略夥伴合作開發設備與製程技術，首度於台灣國際半導體展SEMICON展出封裝產品，宣告群創不僅僅是面板廠，而是more than panel！

# FOPLP 世界上最大的扇出型面板級封裝

群創以面板產線進行IC封裝，以業界最大尺寸G3.5 FOPLP玻璃基板開發具備細線寬的中高階半導體封裝。透過RDL-first及Chip-first封裝工藝，讓此新型封裝不僅變得更薄、更輕、更短、更小，而且藉由更高的電路密度和連接密度來強化封裝的整合能力，使FOPLP能夠在同一封裝面積內，容納更多元件。群創跨足半導體先進封裝，微小化晶片讓生活更智慧，更加豐富。



技術成本降低



利用率達95%



封裝速度加快7倍

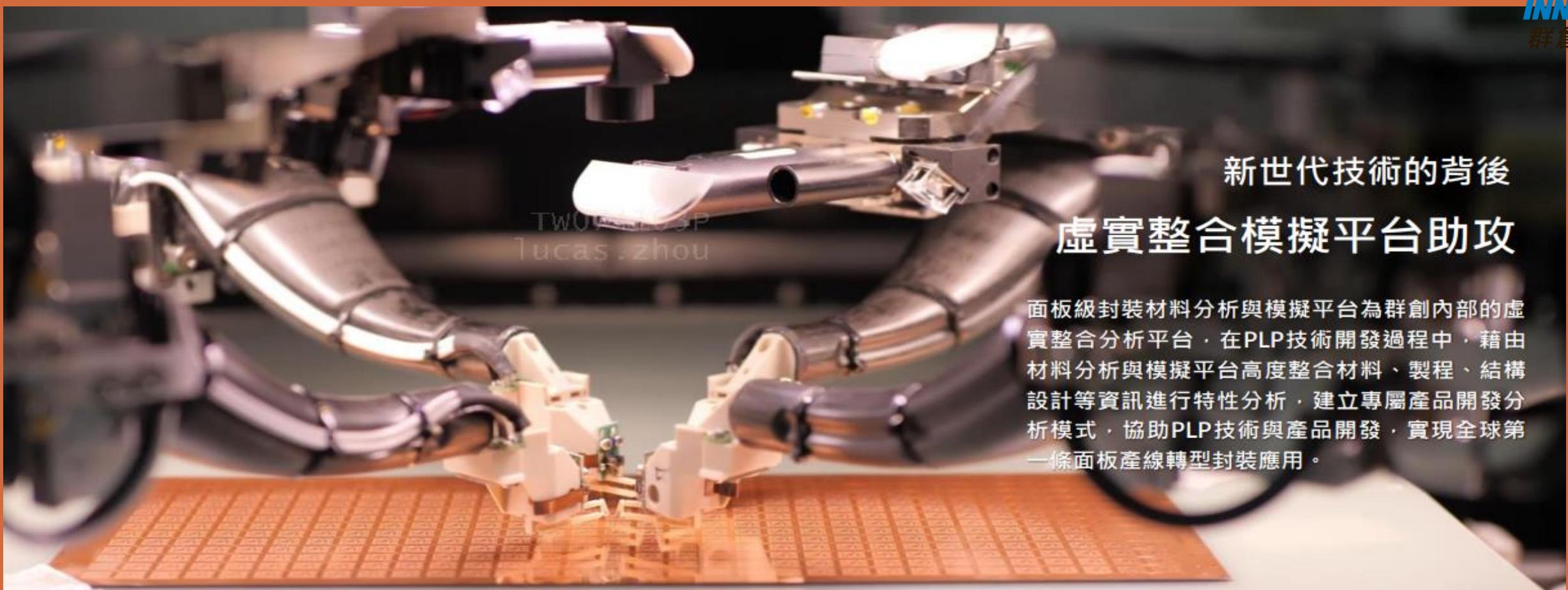


更好的散熱設計



高效能但低耗能

Lucas\_zhong



## 新世代技術的背後 虛實整合模擬平台助攻

面板級封裝材料分析與模擬平台為群創內部的虛實整合分析平台，在PLP技術開發過程中，藉由材料分析與模擬平台高度整合材料、製程、結構設計等資訊進行特性分析，建立專屬產品開發分析模式，協助PLP技術與產品開發，實現全球第一條面板產線轉型封裝應用。

### 1.材料分析

### 2.設計模擬

### 3.製程模擬

### 4.產品可靠度模擬

### 5.產品驗證與失效分析

檢測中心建置各功能實驗室與多種分析設備，藉由內部材料分析與測試結果提供最真實材料參數及驗證回饋。

產品結構與電路佈線設計需配合產品散熱及電性功能模擬分析，並整合熱電分析，提供晶片完善的設計。

整合材料、結構、製程提出最佳化搭配組合，減少材料不匹配效應，克服PLP製程大基板翹曲之技術瓶頸。

對產品進行板級壽命預測及材料破壞風險評估，提前佈局應用場域與回饋材料選用、結構設計、製程條件調整。

將材料、製程、結構設計以及產品驗證與失效分析等特徵與條件進行高度整合特性分析，建立專屬產品開發建模。

# 彈性工作 友善措施

## 彈性調整工作時間



### 使用對象：

有育兒需求/長者照顧需求/同仁親屬及配偶，遇突發性事故需親自照顧之員工

## 彈性調整工作地點



### 使用對象：

有育兒需求/長者照顧需求/工作屬性可連線工作，工作地點不受限員工

近2年約**4,000** 人次使用

## 優化多元給假



### 使用對象：

針對全體員工優於法令給假給薪：如陪產檢假、陪讀假、孝親假、心靈調適假、創寶假

近3年約**62,000** 人次

# 工作&生活 平衡



2024年超過**50,000** 以上人次參加

多元活動/社團任你玩

# 招募最新消息



人才招募網



IG即時動態



未來招募中心

